

昆山市半导体产业 2025 年工作方案

半导体产业的技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。为全面落实中央、省和苏州市关于新型工业化的各项任务，全力推动半导体产业高质量发展，制定本工作方案。

一、发展目标

到 2025 年底，半导体相关产业规模超 350 亿元，创新领航企业库入库企业达 80 家，新增营业收入超 10 亿元企业 3 家、超 50 亿元企业 1 家。建成相对完善的产业生态，产业创新集群初具规模，技术创新活力不断提升，重点发展显示驱动芯片、MEMS 智能传感器和第三代化合物半导体等特色领域，着力填补晶圆制造和设备材料产业链短板环节，发挥我市在先进封装技术的领先地位，加快关键核心技术攻关，培育龙头骨干企业和集成电路产业集群，加快形成具有昆山鲜明标识的特色产业。

二、主要任务

1. 优化产业布局。深遵循产业发展规律，加强统筹协调，指导各区镇根据自身产业基础，科学合理选择半导体产业发展重点方向。支持开发区重点发展中高端芯片设计、先进封装测试、图像传感器等；高新区重点发展 GaN 等新型化合物半导体、通信芯片设计、半导体材料等；花桥重点发展数模转换、物联网等专用芯片设计；旅游度假区重点发展传感器及模组封测；五镇重点发展半

导体配套材料、专用设备及零部件，形成各具特色且优势互补的半导体产业创新集群。

2. 强化产业项目建设。围绕我市半导体产业发展方向，编制产业链招商图谱，瞄准世界 500 强企业、央企、跨国企业、“独角兽”“隐形冠军”企业，持续开展招引对接活动，着力布局 CPU、GPU、存储芯片等主流产品关键项目，适时引进晶圆制造生产线。编制半导体产业重大项目推进计划，强化重大项目管理，建立 5000 万元以上项目库，完善项目督查推进机制，形成“开工一批、竣工一批、投产一批”的滚动发展态势。优化重大项目服务制度，建立服务专班，及时解决项目问题，全面保障重大项目建设。力争 2025 年，新增半导体领域工业投资达 50 亿元。

3. 提升产业技术创新能力。支持昆山工业技术研究院、阳澄湖未来实验室等结合产业布局和市场需求，集中突破 CPU/GPU/FPGA 等高端通用芯片设计、高端电源管理芯片设计、高端 MEMS 传感器设计制造、EDA/IP 核、14/10 纳米及以下节点芯片制造、5G 通信中高频器件设计和制造、超高清图像传感器制造、高端功率半导体制造、先进晶圆级封装、GaN 外延材料、高纯 SiC 衬底材料、高端光刻机和关键零部件等技术。鼓励有条件的企业承担重大项目、重大技术攻关计划，扩大研发投入，提升研发能力。

4. 培育壮大龙头企业。建立健全半导体企业培育动态管理机制，推动生产要素、政策资源、政府服务向龙头企业集聚，着力

培育一批行业影响力大、带动能力强的龙头企业，加快形成以 50 亿元级企业为龙头、10 亿元级企业为主体的龙头骨干企业集群。引导龙头企业兼并重组，支持龙头企业围绕产业链关键环节和核心技术，加强产业链横向联合。鼓励龙头企业探索 IDM 模式，将业务布局向半导体上下游拓展，提升全产业链资源整合能力，降低产品单一、大客户依赖、国际贸易摩擦等风险，加快完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的集成电路创新体系。

5. 培育创新领航企业。 聚焦昆山半导体产业各细分领域，建立半导体创新领航企业库，重点培育一批掌握关键核心技术、创新能力强、经济效益好、拥有自主品牌、具有示范带动作用和凝聚产业集群资源的创新领航企业。鼓励企业申报“专精特新”企业、中国电子信息竞争力百强企业、“单项冠军”和“小巨人”企业。

6. 强化创新平台支撑作用。 依托上海交通大学昆山未来产业创新院、清华科技园昆山分园、工业技术研究院等机构，搭建产业创新平台，推动重大科技创新平台向“高能级”挺进，提升创新平台引领作用，充分“聚能”“释能”“赋能”，激发创新“裂变”。支持企事业单位、高校、科研机构等单位围绕半导体各环节开展技术攻关，共同建设半导体产业研究院等新型研发机构，积极布局建设芯片领域共性技术研发平台。

7. 促进产业链协同发展。 充分发挥龙头企业强链护链作用，鼓励日月新、华天科技、云芯微等龙头企业联合产业链上下游企业组建产业链共同体，提高产业链主导能力，供应链畅通能力和

市场拓展能力，优化产业链企业分工与协同，紧密对接前沿市场需求。摸排半导体企业上游供应链，通过精准招引补断点、强弱项，加强产业内外部协调联动，提升供应链的稳定性。推动产业链间联动，积极引导新型显示、智能网联汽车、高端装备等领域企业与半导体企业开展合作，逐步构建上下游协同的产业链安全和供给保障能力，形成龙头企业引领和中小企业协同发展的产业格局。

8. 提升产业综合服务能力。提升企业支持力度，重点加强对产品首轮流片的生产等高投入领域企业的支持力度，对使用多项晶圆流片研发、首次完成全掩膜工程流片设计的企业以及开展高端传感器首轮流片的智能传感器企业给予专项支持。强化政策服务企业力度，建设半导体产业服务体系，提供增值创新服务，突出半导体产业的优先发展地位，围绕载体建设、重大项目引进、创新平台搭建、人才引进培育、企业做大做强、企业孵化培育等方面，整合优化促进半导体产业发展若干扶持政策，对于重大项目和知名企业落户采取“一事一议”政策。建立电子信息产业项目库，对项目进行分类管理，密切跟进项目建设投产管理指标，加强项目推进工作服务前置，预先防范项目风险，加速优质新项目良性循环。

三、保障措施

1. 强化领导机制保障。组建市级半导体产业发展领导小组，充分发挥领导小组统筹协调、产业抓总等作用，定期召开会议，

制定半导体产业创新集群发展计划，细化分解职责任务，定期通报工作进展，加强目标责任考核，形成既有分工、又有协作的工作格局，充分保障工作的顺利开展。强化统筹机制，整合各方资源，协调解决重大问题，建立重大项目投资决策机制和快速落地联动响应机制，及时解决企业发展面临的实际问题。充分发挥行业专家和智库机构专业作用，对产业发展的重大方向和政策措施开展调查研究，提供咨询意见。

2. 构建金融支撑体系。充分利用国家集成电路产业投资基金，鼓励和引导银行等金融机构加大对半导体产业的信贷支持力度，支持各级信用担保机构为半导体中小企业提供融资担保服务。引导融资租赁公司助力产业发展，支持企业通过融资租赁开展技术改造，支持企业充分利用主板、创业板、科创板等多层次资本市场上市融资发展。支持国资公司加大投入力度，特别是在载体建设、基金组建、产业招商等方面积极作为，打造一支半导体产业创新集群专业化管理运营团队，通过空间、资本、人才等要素的集聚，营造更为优质的产业创新集群生态。

3. 落实跟踪监测。科学开展半导体产业创新集群发展监测工作，结合昆山实际和产业规划制定包括工作目标、具体任务、时间安排、责任人等内容的跟踪监测方案，定期开展产业跟踪监测工作评价，扎实做好产业发展跟踪监测，形成年度监测报告，并向社会公示。强化数据要素支撑，探索形成半导体产业创新集群监测机制，为政策研究、宏观决策等提供支撑。